**请立即发布**

**[SAMTEC LOGO] 2021** 七月

**Samtec发布AcceleRate® HP高性能阵列家族**

*为新款PICMG COM-HPC®互连解决方案奠定基础*

**印第安纳州New Albany:** 市值8亿美元的电子互连解决方案全球供货商Samtec公司深感自豪地发表新一代AcceleRate HP高性能阵列。AcceleRate HP以超微型脚位支持112 Gbps PAM4极致性能。

AcceleRate HP高性能数组包含一款开放式引脚(open-pin-field) 阵列，带来最大的接地与走线灵活性。系统架构师可布线各种高性能差动对、单端讯号、以及高电流的电压输电轨，全部透过同一条互连管道进行传输。

此外，2.2 / 2.4 / 2.2规格的列距(row pitch)让用户更容易布置差动讯号线路。而串扰问题可藉由增加间距以及在差动讯号周围增加接地导孔加以改进。

Samtec, Inc.高速板到板产品经理Michael Boone表示，Samtec新款AcceleRate HP高性能阵列以小型化规格为高速112 Gbps PAM4效能树立标竿。包括AI加速器、ASIC仿真器、以及新一代边缘运算平台在内的高速成长应用都能发挥新产品带来的独特利益。

AcceleRate HP高性能阵列的关键特性包括:

* 高密度0.635 mm间距
* 低高度5 mm 与最高到 10 mm的堆栈高度
* 最多400个针脚
* 未来计划增加到1,000以上个引脚
* 数据传输率兼容于PCIe® 5.0与100 GbE
* BGA焊端(termination)方便组装与自我校准

如欲了解AcceleRate HP高性能阵列详情请访问[www.samtec.com/accelerateHP](http://www.samtec.com/accelerateHP).

**PICMG COM-HPC 连接器**

新发布的PICMG COM-HPC Specification规格带来系统与接口方面的灵活性，采用一对400针脚的连接器，该连接器以Samtec的AcceleRate HP高性能阵列为基础。Samtec COM-HPC Connectors 能将扩充底座连到服务器与客户端模块。它们能支持现有与未来的接口，如PCIe5.0以及最高到100 GbE的网络。连接器对组支持5 mm 或10 mm的堆栈高度。

更多关于Samtec COM-HPC 连接器信息，请下载 [COM-HPCInterconnect Solutions eBrochure](https://suddendocs.samtec.com/ebrochures/samtec-com-hpc-ebrochure.pdf), 造访 [www.samtec.com/COMHPC](http://www.samtec.com/COMHPC) 或 e-mail 技术专家 [COMHPC@samtec.com](mailto:COMHPC@samtec.com).

**关于 Samtec, Inc.:**

Samtec成立于1976年，是一家营收达8亿美元之多样化电子互连方案的私人控股全球制造商，产品涵盖高速板到板、高速电缆、中板和面板光学、精确RF、两件式板到板和微型/坚固的组件和电缆。透过于125个不同国家的40个国际据点，Samtec之全球能见度使其能提供无与伦比的客户服务。更多信息请访问  <http://www.samtec.com>.

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Phone: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[**www.samtec.com**](http://www.samtec.com)

###

**PR 联系:**

Matt Burns

[matthew.burns@samtec.com](mailto:matthew.burns@samtec.com)

812-944-6733